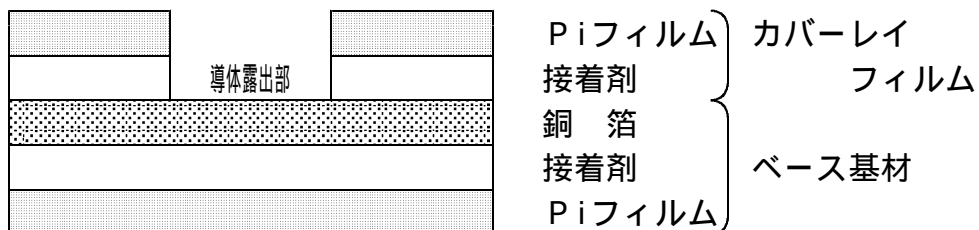


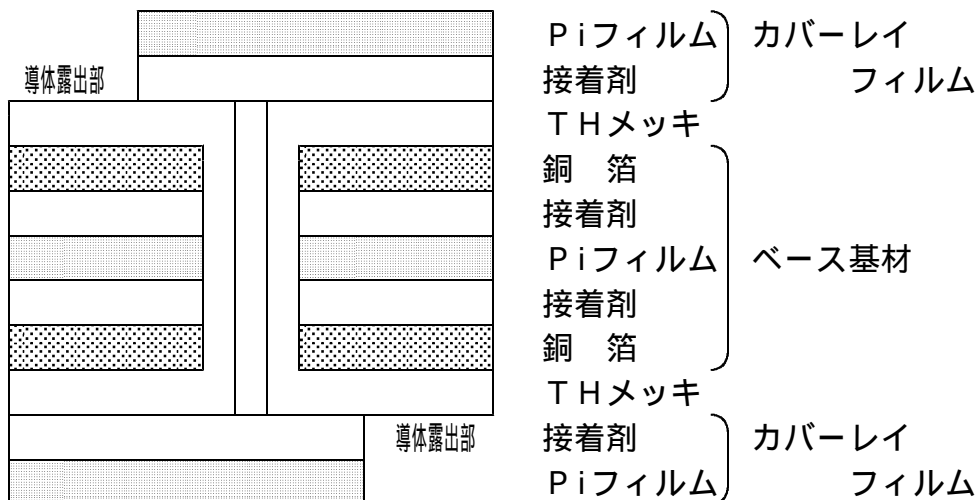
## 製品のご紹介

ベース基材 + フィルムカバーレイ仕様

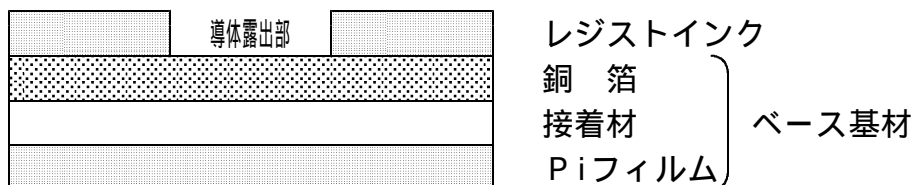
### A) 片面品



### B) 両面品



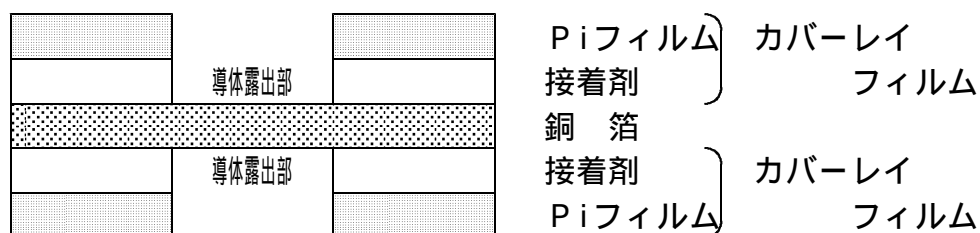
ベース基材 + レジスト印刷仕様



接着材層が無いタイプ(2層材)の選択も可能です。弊社窓口担当にお問い合わせ下さい。

## プリパンチ品

ベース基材を使用せず、銅箔そのものを基材とし、単一の導体層での両面コンタクトが出来る構造です。はんだゴテによる基板同士の接合作業の効率化が期待出来ます。また、総厚みを薄く出来ますのでより一層柔らかいFPCが作成出来ます。但し、配線の交差は出来ません。



## オプション構成

～ のいずれの構成にも、補強板・両面テープなどのオプション材料を付加してFPCを提供する事が可能です。

### A) 補強板

ポリエステル・ポリイミド・ガラスエポキシ板を補強板(裏打ち)として貼り付けます。貼り付けには熱可塑性もしくは熱硬化性接着材を使用致します。

### B) 両面テープ

指定部位に両面テープを貼り付けた状態(セパレータ付)で提供出来ます。製品組立の際に筐体との固定等に御利用下さい。

### C) シルク印刷

指定部位に白色もしくは黒色のインクを塗布する事が可能です。文字の表示、艶消し等を目的とする事が出来ます。

## その他

「環境破壊物質」を削減し、環境に優しいFPCの供給を開始しております。  
RoHS指令の遵守をはじめ、ハロゲンフリー材の扱いも行っております。  
詳細につきましては弊社窓口担当にお問い合わせ下さい。

参考 1 ) ベース基材の厚みについて

：常備在庫      ：入手可      ：特殊材

構 成		片 面				両 面				U L 対応
銅 箔 厚		1 8 μ		3 5 μ		1 8 μ		3 5 μ		
フィルム	接着剤	圧延	電解	圧延	電解	圧延	電解	圧延	電解	いずれも 対応可
1 2 . 5 μ	1 3 μ							-	-	
2 5 μ	1 3 μ							-	-	
	2 0 μ									
5 0 μ	2 0 μ	-	-	-		-	-	-	-	

プリパンチ品は基材を使用しません。銅箔をベースとしております。  
銅箔厚みは、3 5 μ 圧延箔のみとなります。

弊社指定材料に限り、U L 対応が可能です。( U L F i l e N o E 1 9 1 2 5 5、E 1 9 1 2 5 6 )

参考 2 ) フィルムカバーレイ材の厚みについて

：常備在庫      ：入手可      ：特殊材

フィルム	接 着 剤				U L 対応
	1 5 μ	2 0 μ	2 5 μ	3 5 μ	
1 2 . 5 μ				-	いずれも 対応可
2 5 μ	-				
5 0 μ	-	-	-		

弊社指定材料に限り、U L 対応が可能です。( U L F i l e N o E 1 9 1 2 5 5、E 1 9 1 2 5 6 )